PCBs mit additiver Fertigungstechnologie für 5G-und Millimeterwellen-Anwendungen mit hoher Integrationsdichte

Eckdaten

Kurztitel

PaGAnIni

Forschungsschwerpunkt

Sustainable Production, Energy Technologies and Smart Materials

Laufzeit

15.08.2018 - 14.08.2021

Fördergeber

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Werner Bogner, Prof. Dr.-Ing. Stefan Zorn

Ziele

Ziel

Der rapide steigende Bedarf an Leiterplatten und Modulen für 5G- und Millimeterwellenanwendungen (wie z.B. Radare für Sensorik und IoT) erfordert eine kosteneffiziente Volumenfertigung von Schaltungsträgern, welche im 5G- und Millimeterwellenspektrum bis 90GHz reichen. Die Keramiktechnologie wird dabei kosten- und volumentechnisch an ihre Grenzen stoßen, während die Leiterplattentechnologie technologisch an ihre Grenzen stößt. Es wird daher an einer Leiterplattentechnologie für Höchstfrequenzanwendungen geforscht, die subtraktive und additive Verfahren kombiniert und eine mikrogalvanische Lotabscheidung erlaubt.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie

ROHDE&SCHWARZ